

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-027

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）认真践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护股东利益及增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、坚持基础技术、基础材料研究，培育第二增长曲线，科技推动可持续发展

公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，注重研发投入，打造技术驱动型企业，推动可持续发展。

公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI/EMC 器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等领域，客户覆盖全球知名科技企业。目前，公司天线、无线充电、EMI/EMC 等业务持续保持市场优势，导入更多客户产品；高精密连接器、LCP 模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等新业务也逐步获得更多客户机会。除消费电子外，公司在智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等应用领域也取得进展，逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通讯+智能汽车”多业务发展阶段的跨越，为公司的长期、稳定发展及业务规模的进一步扩大提供重要增长力量。

电子信息技术的快速发展，不断重塑世界。每一次技术的突破都带来不一样的创新与变革，企业迎来新的机会与挑战。为更好应对持续变化的复杂环境，积

极把握技术创新下的市场机会，公司重视研发技术的积累，保持较高的研发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

1、基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司持续夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入。在 高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，已开发的 LCP 薄膜、MPI 薄膜等高分子材料薄膜技术，可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 作为一种高分子材料，具有高频低损耗、占用空间小等优点，公司开发的相关材料在 5G 产品中已经大量使用，同时开展了 6G 前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司不局限于单一材料或技术的研发，积极探索同一材料在多个行业（如汽车、工业、航空等）的应用挖掘，以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已有应用并供货；另外，磁性材料还可帮助公司提升天线、射频模组等多类产品的竞争力。在陶瓷材料上，公司具备配方和金属浆料的研发能力，对 MLCC 等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的介电可调陶瓷材料等在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、连接器等的产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案。在散热材料领域，公司已为北美客户提供核心芯片封装散热器件。

2、基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球 10 个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕 5G-A/6G 的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等。随着 5G-A/6G 技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，公司美国、日本研究院对 5G-A/6G 天线模组做了大量的研究工作。如柔性可重构天线是一种具有创新性和实用性的通信

技术，不仅具备分布式天线广覆盖、高容量的优势，还通过智能可重构技术，实现对天线性能参数的实时动态调整，满足复杂多变的通信环境需求。在实际应用中，柔性可重构天线具有广泛的应用前景。公司还在无线充电领域储备了 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低 Dk 介电材料的研发。

未来，公司将积极把握产业创新的机会，始终坚持对基础材料、基础技术的研究与投入，不断夯实企业核心竞争力、加强公司的运营能力，努力成为一家“产品领先+卓越运营”的技术驱动型企业。

## **二、以投资者为本，夯实公司治理，重视投资者回报，与股东共享发展成果**

### **（一）坚持规范运作，提升信息披露质量**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系。为适应上市公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，公司根据相关法律法规及监管要求，结合实际情况对《独立董事工作细则》部分条款进行修订，旨在促进公司治理结构的完善和优化，提升规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。同时，建立多渠道与投资者良性的沟通循环机制，一方面让更多利益相关方参与到企业治理中来，帮助公司不断优化内部治理，更好的落实经营战略规划；另一方面投资者对公司的进一步了解，可以有效减少信息传递的失效以及信息获取的成本，提高投资者的投资决策效率，使上市公司吸纳更多境内外长线优质投资者，股东结构得到不断优化。在不懈的努力与坚持下，公司连续六年获得深交所对信息披露考评最高评级 A 级的评定，努力维护公平、透明、诚信、合规的资本市场形象，与投资者携手共创美好未来。

### **（二）稳定分红，积极回报股东**

公司坚持“以投资者为本”的发展理念，在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报。公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公

司章程》的有关规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，在着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。自 2010 年上市以来，公司已实施现金分红 12 次，累计派发现金分红 55,000.49 万元；近三年累计派发现金分红 19,351.37 万元，占公司近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的 11.55%，与投资者共享企业经营成果。未来公司将继续根据所处发展阶段，结合公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式等，协调好公司发展与股东回报的动态平衡，实现科学、持续、稳定的股东价值回报机制，增强投资者获得感。

### （三）实施回购，提振市场信心

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于人民币 40,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购公司股份拟用于实施员工持股计划和/或股权激励计划，将有利于充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，助力公司的长远发展，提升公司整体价值。

未来公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，持续践行“质量回报双提升”行动方案，积极履行上市公司的责任和义务，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日